



ASM PACIFIC TECHNOLOGY LIMITED

(於開曼群島成立之有限公司)

二零零三年度經審核業績公佈 截至二零零三年十二月三十一日止年度

ASM 於二零零三年度創造超卓成績

- 於裝嵌及包裝設備業繼續保持全球第一位置
- 設備業務增長較其他主要競爭者更迅速，使集團營業額增加41.1%
- 盈利為上市以來的第二高水平，年增長率88.2%

ASM PACIFIC TECHNOLOGY LIMITED 董事會欣悅地宣佈二零零三年全年業績如下：

業績

謹此欣然報告，ASM Pacific Technology Limited 及其附屬公司（「集團」或「ASM」）於截至二零零三年十二月三十一日止年度錄得營業額為港幣2,604,823,000元，與上年度港幣1,846,016,000元比較，增加百分之四十一點一。在扣除因引線框架電鍍工序由香港遷往中國而導致的一次性重組成本港幣5,835,000元後，本年度集團的綜合除稅後淨溢利為港幣535,873,000元，較上年度淨溢利港幣284,704,000元增加百分之八十八點二。是年度每股基本溢利為港幣1.40元（二零零二年：港幣0.75元）。

派息

中期股息每股港幣0.36元（二零零二年：港幣0.36元）已於二零零三年八月派發。在過去數年，集團在微電子市場已建立穩固的基礎，未來將致力透過多元化及高性能的產品擴大市場佔有率，積極加快本體增長。集團在短期沒有重大現金開支，並由一九八八年年底上市後十五年每年均從營運活動產生正現金流量。在擁有充裕的流動資金和股東資金增加的情況下，董事會現建議派發末期股息每股港幣0.84元（二零零二年：港幣0.64元），於二零零四年四月二十八日左右派發。截至二零零三年十二月三十一日止年度全年合計每股派息為港幣1.20元（二零零二年：港幣1.00元）。於二零零零年至二零零三年間，派息率為百分之七十七點九，而本年度派息率為百分之八十六點一。這充份顯示集團決定將剩餘現金回饋予股東時已作審慎考慮，並預留適量的股東資金作集團營運之用。

財務概要

	截至十二月三十一日止年度	
	二零零三年 港幣千元	二零零二年 港幣千元
營業額	2,604,823	1,846,016
銷貨成本	(1,461,851)	(1,072,294)
毛利	1,142,972	773,722
其他經營收益	4,724	7,403
銷售費用	(227,915)	(175,065)
一般管理費用	(108,394)	(96,731)
研究及發展淨支出	(218,360)	(186,980)
廠房遷移開支	(5,835)	(20,000)
經營溢利	587,192	302,349
財務費用	(64)	(168)
除稅前溢利	587,128	302,181
稅項	(51,255)	(17,477)
本年度淨溢利	535,873	284,704
股息	461,414	382,696
每股溢利		
— 基本	港幣 1.40元	港幣 0.75元
— 攤薄	港幣 1.39元	港幣 0.74元

附註：

1. 採納香港財務報告準則

於本年度，本集團首次採納香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則 — 會計實務準則第十二條(修訂)「所得稅」。香港財務報告準則已涵概香港會計師公會所核准之會計實務準則及解釋。

採納會計實務準則第十二條(條訂)對本期或前期所公佈之業績並無影響。

2. 分類資料

分類營業額及業績

業務分類

	截至十二月三十一日止年度	
	二零零三年 港幣千元	二零零二年 港幣千元
收益		
設備	2,165,189	1,459,107
引線框架	439,634	386,909
	<u>2,604,823</u>	<u>1,846,016</u>
業績		
設備	579,573	278,018
引線框架 (備註)	3,685	17,811
	<u>583,258</u>	<u>295,829</u>
未分配之集團收入	3,934	6,520
	<u>587,192</u>	<u>302,349</u>
經營溢利	587,192	302,349
財務費用	(64)	(168)
	<u>587,128</u>	<u>302,181</u>
除稅前溢利	587,128	302,181
稅項	(51,255)	(17,477)
	<u>535,873</u>	<u>284,704</u>

備註：二零零三年業績已扣除廠房遷移開支港幣五百八十萬元(二零零二年：港幣二千萬元)(見附註第5項)。

地區分類

	營業額		業務溢利	
	截至		截至	
	十二月三十一日止年度		十二月三十一日止年度	
	二零零三年	二零零二年	二零零三年	二零零二年
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
a. 業務地區				
中華人民共和國 (「中國」)	1,239,808	1,170,263	230,998	222,803
新加坡及馬來西亞	1,365,015	675,753	352,260	73,026
	2,604,823	1,846,016	583,258	295,829
未分配之集團收入			3,934	6,520
經營溢利			587,192	302,349
			營業額	
			截至十二月三十一日止年度	
			二零零三年	二零零二年
			港幣千元	港幣千元
b. 市場地區				
台灣			516,805	433,557
中國大陸			415,053	274,826
韓國			346,325	168,100
馬來西亞			293,096	228,090
新加坡			222,378	138,085
菲律賓			213,680	98,951
泰國			175,931	108,530
香港			175,238	134,316
美國及加拿大			76,557	115,476
日本			71,148	68,799
歐洲			53,228	42,167
其他			45,384	35,119
			2,604,823	1,846,016

地域分區市場對溢利貢獻未有呈報，因每一地域分區之溢利貢獻與集團之溢利營業額比率大致相符。

3. 折舊

於本年內，集團的物業、廠房及設備之折舊為港幣一億五千三百五十萬元(二零零二年：港幣一億五千六百四十萬元)。

4. 稅項

	截至十二月三十一日止年度	
	二零零三年 港幣千元	二零零二年 港幣千元
本期稅項		
香港	46,511	23,734
其他司法權區	5,322	1,961
	<u>51,833</u>	<u>25,695</u>
以往年度備撥不足(過多)		
香港	143	(1,548)
其他司法權區	940	—
	<u>1,083</u>	<u>(1,548)</u>
遞延稅項		
本期	(2,617)	(6,670)
因稅率變更產生	956	—
	<u>(1,661)</u>	<u>(6,670)</u>
本公司及其附屬公司之稅項	<u>51,255</u>	<u>17,477</u>

香港所得稅是按本年度估計應課稅溢利以稅率17.5% (二零零二年：16%) 計算。

其他司法權區之稅項乃根據有關司法權區之現行稅率計算。

集團新加坡分部獲當地政府頒發「生產總部」榮譽，根據新加坡稅務當局授與之稅務獎勵計劃，本集團在新加坡生產之若干半導體設備及物料新產品所產生之溢利毋須課稅，自二零零一年一月一日起十年內，在新加坡分部履行若干條件下，該等優惠將為有效。

5. 廠房遷移開支

	截至十二月三十一日止年度	
	二零零三年 港幣千元	二零零二年 港幣千元
費用包括：		
廠房搬遷及關閉費用	5,835	512
預提員工離職費	—	15,000
物業、廠房及設備之減值	—	4,488
	<u>5,835</u>	<u>20,000</u>

此費用為集團其中一個廠房由香港遷往中國大陸之開支。

6. 每股溢利

每股基本及攤薄溢利乃根據下列數據計算：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零零三年 港幣千元	二零零二年 港幣千元
計算每股基本及攤薄溢利之 股東應佔溢利	<u>535,873</u>	<u>284,704</u>
	股份之數量(以千位計)	
計算每股基本溢利之加權平均股數	383,410	381,650
來自僱員股份獎勵制度之 潛在攤薄影響	<u>1,479</u>	<u>1,528</u>
計算每股攤薄溢利之加權平均股數	<u>384,889</u>	<u>383,178</u>

業務回顧

於過去三年，半導體與裝嵌及包裝設備行業的市況持續艱巨。經歷二零零零年的蓬勃發展後，取而代之的是黯淡時期，市場未見突破，行業前景亦難以估計。直至二零零二年第二季度市場開始緩慢復甦，唯每季表現仍然反覆。至二零零三年，隨著全球經濟進一步復甦，伊拉克戰事亦宣告結束，不明朗因素得以消除，半導體及其裝嵌設備行業之增長亦與分析員預期相近。根據SIA預測，半導體行業之收入增長為百分之十二至十七、產量增長百分之十五點八，裝嵌及包裝設備市場則增長百分之二十五至三十二。

自二零零三年中，股票市場逐步向好，同時半導體及包裝設備行業於下半年的表現亦顯著較上半年強勁。第四季新訂單數目大幅上升，令業界相信這並非如第二季般屬於復甦週期中的泡沫。集成電路尤其是最新型的 BGA 及晶體度包裝 (CSP) 的需求正全面上升，微距焊線及大量管芯應用亦刺激由產能帶動的焊線機及管芯焊機業務。

儘管本年度首九個月的營商環境仍然困難，唯焊線機的需求於第四季急升，ASM 再度超越同儕，繼續佔據裝嵌及包裝設備業內第一位。集團錄得營業額三億三千四百五十萬美元及純利港幣五億三千五百九十萬元，增長率分別達百分之四十一點一及百分之八十八點二，是 ASM 有史以來的第二高。資本回報率及銷售利潤率分別為百分之三十點七及百分之二十二點四，分別是集團有史以來的第三及第二高。末季的訂貨對付運比率特別高，於二零零三年十二月三十一日的未完成訂單總值為一億一千九百萬美元(於二零零二年十二月三十一日為三千五百萬美元)。

有此成績主要由於集團多年來透過產品及應用市場多元化、有效的成本結構及於過去五年來成功推出新產品以擴大市場佔有率，成功建立起穩固的基礎而得來。於二零零三年，我們的五大客戶共佔集團營業額百分之三十六點九，只有其中一個客戶的銷售額佔超過百分之十。這足以證明我們的市場多元化策略成功。此外，集團的業務廣泛分佈各地，亦反映業內的投資氣候。當中台灣是集團最主要的市場，佔營業額百分之十九點八，中國大陸市場緊隨其後佔百分之十五點九。集團於中國市場的付運量(五千三百三十萬美元)較上年度大幅上升百分之五十一，更創出新紀錄。

行業放緩正好為 ASM 創造寶貴的機會，把我們嶄新及性能超卓的產品推出市場，擴大市場佔有率。集團現時擁有業內最大的市場份額，在此優勢下，佔集團二零零三年營業額百分之八十三點一的設備業務，較去年增長百分之四十八點四至二億七千八百萬美元，增長率超越業內所有主要競爭對手。此外，我們進一步拉遠與最接近的競爭對手之收入差距至百分之十八點五，高於去年的百分之四點七及過去十二個月(零二年下半年至零三年上半年)的百分之十四點一。集團有此佳績，充份反映集團主要客戶對 ASM 產品及服務的接受及滿意程度，亦顯示 ASM 成功於競爭對手中突圍而出。另一傑出成績是，於二零零三年十二個月內，集團的股價及市值上升達百分之一百二十五，反映投資界對我們所付出的努力之認同。

引線框架業務佔集團營業額百分之十六點九，本年度營業額增加百分之十三點六至五千六百五十萬美元，較 SEMI 公佈之百分之八點二市場增長率為高。集團如期把整個沖壓框架生產工序遷往位於中國福永的綜合式廠房。現在我們可採取更進取的競爭策略，產量可按需求增加一倍，架構亦更具成本效益：員工薪酬及租金支出減少、生產週期縮短及半成品數量減至最少。為提升 QFN 及微距焊點產能，集團除在第四季於新加坡廠房裝設一條全新的蝕片生產線外，亦訂定於馬來西亞 Pasir Gudang, Johor Bahru 興建一個面積達280,000平方呎的新廠房，主要為發展我們的引線框架業務。預期此計劃將於二零零五年年初完成。除擴充我們的蝕片框架電鍍工序外，我們亦計劃於該年度較後期在這新廠房增設沖壓生產設備，令集團於馬來西亞及新加坡之沖壓框架業務更具效益。有關廠房、電鍍生產線及額外生產機器之初期投資額為一千二百萬美元，已包括在我們二零零四年的資本性投資計劃內。

正當我們大部分的競爭對手裁減人手、縮減項目以盡量降低其現金流出之際，ASM 反而加速技術及產品的開發。去年，我們的研發開支實質上增加至港幣二億一千八百四十萬元(二零零二年：港幣一億八千七百萬元)，佔設備銷售額的百分之十點一(二零零二年：百分之十二點八)。ASM 的 Eagle 60金線焊機擁有較我們競爭對手超前一代的35 μ m微距焊線技術，成功在多項基準測試中脫穎而出，令集團贏得數個重要的集成電路新客戶。當中包括三間全美國五大半導體公司，應用我們的金線焊於尖端科技的 BGA、TAFP、影像感應及銅線焊接，另有三間分別來自新加坡、香港及中國的著名包裝公司，及兩間於半導體業內享負盛名的美國集成裝置製造商。隨著300毫米晶片的面世及大量管芯包裝的需求，我們高速而嶄新的集成電路管芯焊接機正逐步擴大市場佔有率及奠下鞏固基礎。從取得首批訂單的實例中證明了創新的產品，如覆晶焊接機及軟焊料晶片焊接技術，已成功為我們開拓從未涉足的新市場之商機，從而強化了 ASM 在晶片焊接工序方面的領導地位。

我們需要處理的金線焊機訂單數目急速上升，與二零零零年的水平相近，因此半製品亦要相應增加以應付更多元化的產品需要及因應客戶要求縮短交貨期，ASM 近年廣泛應用於全球業務的企業資源計劃 (ERP) 軟件已證明能有效地簡化我們的物流及存貨管理。於二零零一年及二零零二年，我們連續兩年成功把存貨合共減少港幣一億八千六百萬元，儘管集團於二零零三年的存貨周轉率提升至五點零三週次，表現較過去數年大幅改善，我們僅需把存貨輕微提升 (百分之四點七) 港幣二千三百七十萬元至港幣五億二千九百五十萬元。綜合營運資本轉變及營運所帶來的溢利，我們於年內產生港幣三億九千二百六十萬元的自由現金流量 (Free Cash Flow) (二零零二年：港幣三億五千八百八十萬元)，及錄得投入資本回報率達百分之三十九點七 (二零零二年：百分之十九點六)。

流動資金及財務狀況

於二零零三年十二月三十一日，集團的股東資金輕微上升至港幣1,915,502,000元 (二零零二年：港幣1,756,072,000元)。如過去四年一樣，集團並沒有長期借貸，負債比率為零。

儘管派發了港幣三億八千三百三十萬元的股息，及於十二個月內投入了港幣一億六千零五十萬元作資本性投資，由於營運資金控制得宜及現金流入強勁，於二零零三年十二月三十一日，手頭現金微升港幣513,078,000元 (二零零二年：港幣465,569,000元)。事實上，集團主要的資本性投資乃由是年度港幣一億五千三百五十萬元的折舊所支付。

於二零零三年十二月三十一日，集團並沒有任何銀行借貸。流動比率為三點二。集團的應收賬款主要來自第四季的收入。在嚴謹的監控下，應收賬款週轉率維持在九十六點四天。

集團主要之銷售貨幣單位為美元，因此匯率風險非常低。另一方面，集團主要以美元、港幣、新加坡幣及人民幣支付開銷。有限量的日圓應收賬款足夠應付部份應付予日本供應商賬款。

人力資源

集團與員工訂立了具競爭力的薪酬制度。除員工薪金外，集團亦為員工提供其他福利，包括退休供款計劃及醫療津貼。此外，視乎集團的業績及個人表現，個別的花紅及紅股可按需要分發予應嘉許員工。整體而言，集團每年會進行一次薪金調整，並致力維持其嚴謹的員工培訓計劃。

於二零零三年十二月三十一日，集團全球聘用約六千二百名員工。

展望

隨著美國經濟於大選年逐步改善，消費市場前景更為樂觀，再加上半導體之應用繼續滲入新市場，大部份行業分析員如 Dataquest、VLSI Research、SIA、IC insights、Semico、iSuppli 及 WSTS 目前均預測半導體業於二零零四年之增長將超過百分之二十(介乎百分之十七至二十九)，而二零零五及二零零六年則保持穩定增長。根據 In-stat 預測，集成電路產量將增長百分之十三點二。有見晶體度包裝如 QFN 已被應用於新一代的無線通訊及手提設備設計上，預期這將加快晶體度包裝之增長步伐。

至於裝嵌設備市場方面，大部份專家 (Dataquest、SEMI 及 VLSI) 樂觀預期二零零四年的增長率將達百分之三十八至四十，而二零零五年亦將錄得雙位數字之增長(百分之二十至三十五)。然而，過去兩三年行業的蕭條景況仍記憶猶新，保守派認為這些預測過於理想。幸而最近數月來股票市場對高科技公司之評價變得較為正面，令我們的客戶能更容易獲取資金以支持他們的資本性開支，從而令二零零四年成為裝嵌設備市場蓬勃發展的一年。

ASM 正積極增設零件生產機器以提升產量，並致力控制我們的設備付貨期於客戶可接受的範圍內。近期，我們於香港及中國的廠房分別擴展了28,000平方呎及20,000平方呎的樓面面積。此外，我們已增聘銷售及服務人員、生產及產品研發人員以應付不斷增加的手頭訂單。集團的手頭訂單已回復至二零零零年的水平。集團二零零四年的資本性投資為港幣二億五千萬，將用作投資於馬來西亞引線框架項目和提升引線框架生產能力、科研能力及資訊科技基礎建設。

為鞏固我們與重要客戶之策略性夥伴關係，我們應用 ASM 的設備及引線框架為他們提供不同的包裝解決方案，包括多層管芯、影像感應組件、高亮度 LED、以銅線焊接的電源設備、QFN 包裝等。結合我們於晶片焊接、覆晶、焊線、塑封工序及引線框架設計的豐富知識，ASM 解決方案的銷售模式令集團於芸芸競爭對手中脫穎而出，開啟了那些不接受單一產品測試之客戶的大門。

ASM 繼續透過其設備產品為客戶提供改良增值建議，以滿足他們不斷轉變的需求，藉此維持 ASM 於業內的領導地位。我們的客戶正面對種種艱巨的挑戰。先進晶片組裝要求低k電介體，更微細的管線闊度及銅線焊接，而多層管芯、覆晶及晶片包裝技術正好能滿足先進晶片組裝對纖細度、速度及電子設備性能的要求。此外，配合最新的管線闊度、300毫米晶片大大減低每個裝嵌於集成電路之管芯價格，因而令集成電路裝嵌成為較昂貴的工序。電子產品受市場壓力而持續減價，我們的客戶在面對巨大減價壓力的同時，仍需投資於新一代的焊接機上以裝配這些先進包裝。

為滿足市場對創新解決方案的需求，ASM 研發及設計出一系列管芯、焊線及覆晶焊接機以配合大小不同的管芯、裝配程序、墊距需要及成本考慮。集團將於年內推出新的集成電路管芯及焊線機系列，這將進一步鞏固 ASM 於管芯裝配及焊線市場的主導地位。為繼續加強與客戶之密切關係，我們正研發若干方案以於影像感應組件裝配晶體、利用覆晶熱能超聲波工序組裝高亮度 LED、以4-6 mil 銅線代替較粗的鋁線焊接電源設備及結合若干工序於一晶片層面或 test handler。集團透過滿足客戶各項獨特應用所需，進一步鞏固業務關係，並為其他主流產品帶來商機。

憑藉我們針對不同應用市場的多元化產品、具市場領導地位的管芯焊機及焊線機於蓬勃時期帶來產能相關之業務、一系列備有出色工序及技術的新產品、以及最具成本效益結合產品設計及生產的垂直整合業務模式，集團於過去數年已奠下穩固的基礎。因此，ASM已準備就緒以受惠於目前這充滿活力的市場環境及面對未來種種挑戰。

購買，售賣或贖回本公司股份

本公司及其附屬公司並沒有於是年度內購買、售賣或贖回本公司之股份。

在聯交所網頁登載詳細的業績公告

本公司載有根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）證券上市規則附錄十六第45(1)至45(3)段所規定的全部資料的業績公告將在適當時間在聯交所網頁登載。

股東大會

本公司股東大會茲定於二零零四年四月二十三日舉行，本公司年報及股東大會通告將寄發予各股東。

承董事會命
董事
林師龐

香港，二零零四年二月二十四日

股東週年大會通告

茲通告 ASM Pacific Technology Limited (「本公司」) 謹定於二零零四年四月二十三日下午三時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場一座五樓太古廣場會議中心舉行股東週年大會，以商議下列事項：

1. 省覽及接納截至二零零三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。
2. 宣派截至二零零三年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣0.84元。
3. 選舉董事及授權董事會釐定董事酬金。
4. 重新委聘核數師及授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
董事
林師龐

香港，二零零四年二月二十四日

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開之大會並於會上投票之股東均有權委任一位代表，代其出席大會及於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會或其續會舉行時間最少48小時前送達本公司在香港之主要辦事處，地址為香港葵涌工業街16-22號屈臣氏中心12樓，方為有效。
3. 本公司將於二零零四年四月十五日至二十三日(首尾兩天包括在內)暫停辦理過戶登記手續。為合符享有擬派之末期股息之資格，所有過戶文件連同有關股票須於二零零四年四月十四日下午四時正前送達本公司之香港股份過戶登記處 Secretaries Limited，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下。

請同時參閱本公佈於(香港經濟日報及信報)刊登的內容。